

EINLADUNG ZUM TECDAY

IM STEIGERWALDSTADION ERFURT
AM 04. JUNI 2024



LIEBE KUNDEN UND TECHNIK-INTERESSIERTE

lassen Sie sich von praxisnahen Vorträgen aus den verschiedenen Bereichen der Leiterplatte inspirieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen, Problemlösungen zu diskutieren und anstehende Projekte zu besprechen, denn wir unterstützen Sie bereits in der frühen Entwicklungsphase Ihrer Produkte.



Termin
Dienstag, 04. Juni 2024



Uhrzeit
Beginn ab 08:15 Uhr
Agenda - siehe nächste Seite



Standort
Steigerwaldstation Erfurt
Mozartallee · 99086 Erfurt



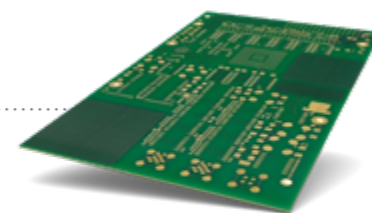
Gleich anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Anmeldeschluss 31. Mai 2024.

Anmeldung unter: www.we-online.com/tecday-erfurt



Begleitend zu den Vorträgen, steht Ihnen eine Tabletop-Ausstellung zur Verfügung

- Ausstellungsmaterial, Exponate der Leiterplatte



AGENDA UND TAGESPLANUNG

Registrierung 08:00 – 08:15 Uhr

Begrüßung 08:15 – 08:30 Uhr

Programm ab 08:30 Uhr

Design for HDI-Manufacturing + Zuverlässigkeit und Impedanzen

Design for HDI-Manufacturing

- Tipps aus der Praxis zur Optimierung von Designs
- Grenzen verschiedener Herstellverfahren

Zuverlässigkeit und Impedanzen

- WE.SPEED: High Speed Materialien am Beispiel Panasonic Megtron6™
- Impedanzprüfung im Zeitalter von Hochfrequenz-Lagenaufbauten am Beispiel Panasonic Megtron6
- Interconnect Stress Test: Lessons Learned nach 10 Jahren IST Prüfung
- Zuverlässigkeit im Design

Referent: Andreas Dreher

SLIM.flex und PURE.flex

- SLIM.flex: Miniaturisierte Leiterplatten in Anylayer-Microvia-Technologie
- SLIM.hdi: Miniaturisierte Leiterplatten in Anylayer-Microvia-Technologie als Substrattechnik
- PURE.flex mit Stiffener: Materialien und Anwendungen

Referent: Michael Kress

Advanced Solutions & Innovationen

Suchen Sie nach einer Lösung? Wir werden sie finden!

DEVICE.embedding –

oder wie und warum steckt man Bauteile in die Leiterplatte?

- Kurzer Überblick über die Embedding-Möglichkeiten
- Design Rules für den PCB Designer
- Beispiele von Applikationsmöglichkeit

Referent: Leon Haase

Pausen zur Erholung

Ende der Veranstaltung, 17:00 Uhr

WEdesign

- Bauteile/Bibliotheksanlange
- Layouting/Redesigns
- Simulation und Verifikation (thermisch, SI, PI)
- Bereitstellung optimierter Fertigungsdaten
- Leiterplattenherstellung

Referenten: Michael Matthes

Printed Polymer und Wärmemanagement

„Lösungsbringer am Beispiel einer anspruchsvollen Automotiv-Anwendung“

Referent: Andreas Dreher

STARR.flex – die zuverlässige Verbindung im 3D-Bauraum

- Systembetrachtung
- Lagenaufbauten und Materialkombinationen
- Mechanische und elektrische Optionen
- Grundlagen | Motivation | Materialien | Kosten
- Praxisteil: Herstellung starrflexible Leiterplatten live

Referent: Melih Cakirbey

Besichtigung des Steigerwaldstadions